

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

510

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

10.08.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	B00	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	177		2		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3		
A-RS-FR4-ML-0.41mm-018+018-TG150-HF	50200904	18	L2	4		A01
		410				
		18	L3			
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	188		5		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		7		
A-RS-FR4-ML-0.41mm-018+018-TG150-HF	50200904	18	L4	8		A02
		410				
		18	L5			
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	173		9		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		10		
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	11		

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1466 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik